

证券代码：688401

证券简称：路维光电

深圳市路维光电股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☒ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场调研 ☒ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称	中泰证券、中信证券、国泰海通证券、中金公司、中信建投证券、国联民生证券、浙商证券、长江证券、华创证券、长城证券、国投证券、中邮证券、方正证券、财通证券、开源证券、招商证券、天风证券、国信证券、华源证券、国金证券、江海证券、山西证券、华西证券、东兴证券、平安证券、易方达基金、广发基金、工银瑞信基金、宏利基金、新华基金、圆信永丰基金、信达澳亚基金、财通资管、淳厚基金、诺安基金、创金合信基金、博时基金、博衍基金、恒生前海基金、益民基金、汇百川基金、华泰资管、长城财富保险资管、长江养老、招商资管、方正资管、中银资管、百年人寿保险、中电科投资、高新投、磐厚动量、英大资本、华辰资本、广东伟晟投资、上海钦沐资产、海南鑫焱创业投资、杭州弈宸私募、深圳前海华杉投资
调研时间	2025 年 4 月 29 日
会议地点	公司会议室、进门财经
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监：刘鹏先生 投资者关系：刘文鑫女士
投资者关系 活动内容记录	1、公司 2024 年经营情况介绍？ 2024 年公司实现营业收入 87,554.87 万元，同比增长 30.21%，主要得益于下游行业需求旺盛、公司产能稳步提升。从收入结构看，2024

年平板显示掩膜版仍是公司的主要收入来源，其中 OLED 用掩膜版的增速明显，带动平板显示掩膜版的整体增长；公司的第二成长曲线半导体掩膜版初显峥嵘，发展前景广阔，尤其是先进封装掩膜版的表现亮眼，公司已成为许多下游封测厂的头部供应商。2024 年公司实现归母净利润 19,086.22 万元，同比增长 28.27%；实现扣非归母净利润 17,371.48 万元，同比增长 39.56%。

凭借优秀的产品性能与优质的服务，公司吸引了更多优质客户，2024 年公司新导入客户 100 余家，总合作客户 400 余家，其中公司在 80 多家长期合作客户的销售收入实现超 30%的增长，在国内某领先芯片公司及其配套供应商、京东方、寰采星、蓝思科技、成都奕成等客户供货量有较快提升。

按下游应用分类	主要下游客户
LCD、OLED及TP	京东方、天马微电子、TCL华星、信利、蓝思科技
Micro LED 及 Micro OLED（硅基OLED）	华灿光电、上海显耀（JBD）、天马微电子、三安光电、熙泰智能、重庆康佳、辰显光电
FMM	宁波寰采星、众凌科技
IC制造以及IC器件	国内某领先芯片公司及其配套供应商、宁波中芯集成、士兰微、三安光电、锐石创芯、泰科天润、扬杰科技、光迅科技、舜宇奥来、睿创微纳、高德红外、海康威影、赛莱克斯（赛微电子）
先进封装	华天科技、晶方半导体、通富微电、某三维多芯片集成领先企业、甬矽电子、安靠科技（Amkor）、日月新（日月光旗下）、上海豪威、先进半导体（先进封装材料国际有限公司）、硕中科技、苏州矽品、成都宇芯、成都奕成（板级封装企业）、通格微（玻璃基板封装企业）
封装载板	奥特斯、礼鼎半导体
半导体设备	上海微电子、新凯来、芯碁微装、智慧星空（广东星空科技装备有限公司）、上海精测

2024 年公司“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产”等项目投产后，产能迅速爬坡释放，为公司贡献了可观的营业收入和利润总额。公司可转换公司债券项目中的“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”，已就新增的 2 条半导体掩膜版生产线和 2 条高精度平板显示掩膜版生产线之关键设备完成主要设备合同谈判和签署；该项目产品涵盖 250nm-130nm 半导体掩膜版和 G8.6 及以下高

	精度 a-Si、LTPS、AMOLED、LTPO 等平板显示掩膜版产品,预计在 2025 年完成新增产线建设并逐步释放产能。 公司投资建设的路芯半导体 130-28nm 半导体掩膜版项目已于 2024 年 6 月完成主厂房封顶,并于 2024 年第四季度开始陆续搬入设备,其制程节点布局居于国内厂商前列。该项目总投资规划 20 亿元,一期计划投资 14-16 亿元,产品覆盖 130-40nm 制程节点半导体掩膜版,一期在 2025 年上半年送样 90-100nm 制程节点半导体掩膜版,2025 年下半年试产 40nm 制程节点半导体掩膜版产品,有望在 2025 年完成投产并贡献部分收入,在 2026 年进一步放量;二期计划投资 4-6 亿元用于 40-28nm 制程节点半导体掩膜版产线建设,预计将于 2026-2027 年推进建设,建设周期在 2 年以内,具体项目推进情况可能因市场需求或实际情况提前或延后。 为进一步扩充公司高世代高精度掩膜版的产能,公司计划在厦门市投资 20 亿元,建设“厦门路维光电高世代高精度光掩膜版生产基地项目”,主要生产 G8.6 及以下的 AMOLED 等高精度光掩膜版产品,项目 2026 年有望开始贡献收入。 2、公司 2025 年一季度经营情况? 2025 年一季度公司实现营业收入同比增长 47%,主要是一季度公司产能提升,高端的 AMOLED、先进封装、FMM、PSM 等高端产品进一步放量,加之下游需求旺盛,带动营业收入稳步增长。归属于上市公司股东的净利润同比增长 20%,增速低于营业收入,主要是受汇兑损益影响,同期来看去年的一季度和四季度都是汇兑收益。若剔除汇兑损益影响,公司一季度归属于上市公司股东的净利润增速高于营业收入增速。 3、公司有哪些技术优势? 公司产品技术国内领先,多次打破海外垄断。(1)在 G11 高精度超大尺寸掩膜版领域,公司于 2019 年成功建设国内首条 G11 高世代掩膜版产线并投产,成为国内首家且唯一一家、世界第四家掌握 G11 掩膜版生产制造技术的企业;(2)在半色调掩膜版(HTM)领域,公
--	--

公司于 2018 年成功实现 G2.5 等中小尺寸半色调掩膜版投产，并于 2019 年先后研发并投产 G8.5、G11 TFT-LCD 半色调掩膜版，2024 年量产 AMOLED 用 HTM 掩膜版产品，HTM 产品目前可以覆盖全世代，打破国外厂商长期技术垄断；（3）在 PSM 领域，公司于 2021 年完成衰减型相移掩膜版 (ATT PSM) 工艺技术研发并通过内部测试，2023 年量产 Metal Mesh 用 PSM 掩膜版，CF 用 PSM 产品于 2024 年通过客户验证并量产，TFT-Array 用 PSM 掩膜版产品已打通关键环节，计划于 2025 年进行试样验证；AMOLED PSM 用掩膜版产品正在推进前期预研，根据客户技术迭代与市场需求，逐步推进量产；2024 年完成研发单层衰减型 PSM 掩膜版制造技术及 Mosi 系双层 PSM 掩膜版制造技术研发，可应用于 G6 及以下平板显示掩膜版以及半导体掩膜版。（4）在光阻涂布领域，公司分别于 2016 年、2018 年自主开发了中小尺寸和大尺寸掩膜版光阻涂布技术，实现了国内掩膜版行业在高精度、大尺寸光阻涂布技术上零的突破及对产业链上游技术的成功延伸。

4、怎么看待掩膜版行业的景气度？

伴随半导体制程节点向前推进、LCD 向 OLED 切换、LTPS 向 LTPO 切换，下游行业对掩膜版的需求层数、单片精度都不断提升；下游应用场景不断扩展催生更多种类，例如 AI 芯片、汽车电子、Micro-LED 等；封装技术革新催生先进封装掩膜版需求高增，例如 Chiplet、3D IC、FOPLP 等先进封装技术发展带动 RDL/TSV 等工艺用掩膜版需求提升；显示技术迭代，例如 8K、折叠屏、透明 OLED 等。掩膜版的需求增长不仅是“量”的增加，更是“质”的升级（精度、尺寸、材料适配性）；下游面板行业、半导体行业本土化趋势带动本土掩膜版需求增长。下游应用的多元化（从传统芯片到 AI、汽车、AR）和技术演进（EUV、Chiplet、Micro-LED）共同推动行业进入高景气周期。

5、国内半导体掩膜版的市场空间有多大？

根据多方机构预测需求综合研判，预计 2025 年全球半导体掩膜版的市场规模为 89.4 亿美元，其中晶圆制造用掩膜版为 57.88 亿美元、封装用掩膜版为 14 亿美元，其他器件用掩膜版为 17.5 亿美元；

	2025 年国内半导体掩膜版市场规模在约为 187 亿人民币，其中晶圆制造用掩膜版预计为 100 亿人民币，封装用掩膜版预计为 26 亿人民币，其他器件用掩膜版为 61 亿人民币。受下游需求的积极推动，未来掩膜版市场规模也将持续增长。 6、掩膜版在先进封装的应用有哪些，公司在先进封装掩膜版的进展？ 先进封装的各主要工艺环节，重布线层 RDL、硅通孔 TSV、微凸块、电镀互连，以及封装基板等的制造都高度依赖光刻技术和掩膜版来实现精细结构的形成。RDL 通过多层光刻实现复杂扇出布线，是掩膜版使用的重要场景，其层数正不断增加；TSV 制造涉及硅深孔图形和金属互连，需要高精度掩膜定义；微凸块电镀成形完全由掩膜版图形控制尺寸和位置；封装基板的每层布线都须掩膜曝光，且层数远超芯片金属层，是掩膜版消耗的另一主要来源。此外，一些辅助和新兴步骤同样用到掩膜工艺。更高的 I/O 密度驱动更多层次的 RDL 与基板、更细的凸点、更复杂的中介层，从而推高对掩膜版数量和精度的需求。 公司布局先进封装已久，客户资源丰富，作为国内先进封装掩膜版龙头，是多个领先封测厂的头部供应商，技术和产品布局全面，产品可满足国内各种先进封装要求，例如晶圆级封装、2.5D/3D 封装、系统级封装、扇外型封装、CoWoS 先进封装等需求。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单	无